

半導體國際人才培育獎學金實施計畫

115年2月24日全球事務處行政會議訂定通過

一、目的：為培育半導體產業人才，國立清華大學（以下簡稱本校）與臺灣積體電路製造股份有限公司共同設置本獎學金，以獎勵半導體相關領域之頂尖國際學生。

二、實施期間：春季班為114-117學年度，秋季班為115-118學年度。

三、合作學院：理學院、工學院、原子科學院及電機資訊學院。

四、資格條件

（一）依外國學生來臺就學辦法至本校攻讀學位，且獲得本校國際學生獎學金 A 類之二年級以上學生，經遴選表現頂尖者。

（二）依僑生回國就學及輔導辦法至本校攻讀學位，且獲得教育部、僑務委員會或本校僑生獎學金之二年級以上學生，經遴選表現頂尖者。

五、受獎金額

博士班每月新臺幣二萬元，碩士班每月新臺幣一萬五千元，學士班每月新臺幣一萬元。

六、受獎期限

獲得本獎學金者，每次受獎期限為一年。但受獎生原領取之教育部、僑務委員會或本校獎學金期限屆滿，本獎學金將同時屆期。

七、獎學金撤銷、廢止及停發

獲得本獎學金者，如其原領取之教育部、僑務委員會或本校獎學金遭撤銷、廢止或停發，本校將一併撤銷、廢止或停發本獎學金，且受獎生須繳回溢領款項。

八、本計畫經全球事務處行政會議通過後實施。